外部電場によって配列する液晶結合金ナノロッドの 小角X線散乱および偏光異方性測定

(愛知教育大1,千葉大院融合2,日大文理3) 河内 恵理佳 1, 堀田 裕康 1, 森田 剛 2, 畠山 義清 3, 西川 恵子 2, 日野 和之 1

Small angle X-ray scattering and polarization anisotropy measurements of liquid-crystal-capped gold nanorods aligned by an external electric field

(Aichi Univ. of Edu.¹, Grad. Sch. of Adv. Integ. Sci., Chiba Univ.², Col. of Hum. and Sci., Nihon Univ.³) Erika Kochi¹, Hiroyasu Hotta¹, Takeshi Morita², Yoshikiyo Hatakeyama³,

Keiko Nishikawa², Kazuyuki Hino¹

【序】我々は、電場応答性の高いシアノビフェニル系液晶のアルキル末端をチオール化した分子 (HS80BPCN,図1)を金ナノロッドに結合させることで、ナノロッド間に配列相互作用がは たらくことを小角 X 線散乱(SAXS)測定によって確認している。本研究では、この相互作用を もとに、外部電場によって金ナノロッドの配列およびその光学特性を制御することを目的として いる。これまでに、液晶結合金ナノロッドの DMF 溶液に対して、外部電場を印加する前後で SAXS 強度が大きく変化することを確認したが、S/N 比が悪く十分な再現性が得られていなかった。

今回は、電場印加前後での SAXS 強度の変化について再現性 を確認するとともに、別の測定手法として偏光異方性測定を Hs 行い、電場印加による配列構造の変化について検討した。

図1. HS80BPCN の構造

【実験】(1)シード成長法:塩化金酸(HAuCl4)水溶液にセチルトリメチルアンモニウムブロ マイド(CTAB)水溶液を加え、テトラヒドロホウ酸ナトリウム(NaBH4)を加えて塩化金酸イ オンを還元し、金ナノ粒子を生成させた(Seed 溶液)。HAuCl4 と CTAB の水溶液に規定量の AgNO3 水溶液を加え、さらにアスコルビン酸水溶液を加えて Au(I)に還元した (Growth 溶液)。 続いて、Growth 溶液に少量の Seed 溶液を加え、撹拌後静置するとシード粒子が一次元方向に成 長し、長さ数十 nm の金ナノロッドが生成した。金ナノロッドのアスペクト比(~5)は、添加 する AgNO3の量で制御することができる。より高いアスペクト比(5~)の金ナノロッドの調製 は、CTAB だけでなくベンジルジメチルヘキサデシルアンモニウムクロライド(BDAC)も加え た Growth 溶液を用意し、シード成長法を繰り返すことで行った。

(2) 配位子置換法:調製した金ナノロッド水溶液に HS80BPCN のクロロホルム溶液を加え撹 拌し、CTAB を置換した。それから遠心分離により沈殿物を回収した。

(3) SAXS 測定:液晶分子が結合した金ナノロッドの DMF 溶液を調製し、フォトンファクト リーBL-6A で SAXS 測定を行った。専用セル中の溶液に対して電場を印加しない場合(OFF)と 電場を印加した場合(ON)で測定を行った。得られた散乱プロファイルを解析し、電場印加の効 果を調べた。電場強度は、~1.1×10⁶ V/m に設定した。

(4) 偏光異方性測定:液晶結合金ナノロッドのプラズモン吸収に対する偏光異方性測定を行っ た。専用セル中の溶液に対して、2つの偏光角(0°,90°)の場合の吸光度を、それぞれ電場 OFF と電場 ON の場合で測定し、電場印加の効果を調べた。各偏光角における吸光度は、3 秒間隔で 400 カウント測定した平均値を使用した。電場強度は、~1.1×10⁶ V/m に設定した。

【結果と考察】図2に、液晶分子が結合したアスペクト 比6の金ナノロッド溶液の SAXS 強度を散乱パラメー ターに対して示す。電場 OFF に対して、電場 ON の場 合に SAXS 強度が大きく減少した(減少率 60.5%)。こ れは以前の測定結果と一致した。また、アスペクト比4 のナノロッドの場合も同様に、電場印加による SAXS 強度の減少が確認できた(減少率 20.4%)。

この減少が、ナノロッドの集合構造の変化によるもの かどうかを調べるために、散乱プロファイルから距離分 布関数(DDF)を求めた(図3)。DDF 強度は SAXS 強度に依存するので、電場 ON の場合に DDF バンド強 度は減少する。ここではバンド形状の変化から電場印加 による配列構造の変化を議論するために、短距離部分 (~100Å)のバンドピークを規格化した。電場 OFF に比べて電場 ON の場合に、長距離側(~400Å)のバ ンドの相対強度が増加している(増加率 30.0 %)。

SAXS 強度の減少は次のように考えられる。散乱強度 は、X 線散乱に寄与する試料の実効体積に依存する。電 場 ON の場合には、ナノロッドが電場方向に並び合 い、電極方向から見るとロッド末端面がまるで等方 的な分布をもつ試料のように振る舞う。その結果、 実効体積が減少し、SAXS 強度が減少する(図4)。

DDFの長距離側のバンドは、液晶分子を結合させていないナノロッドでは観測されない。このバンドは、液晶分子が結合することによってナノロッド間





図3.アスペクト比6の金ナノロ ッド溶液の距離分布関数



図4. 電場印加による配向度の変化

に緩やかな配列相互作用がはたらくことを示す。DDFの形状変化は、電場 ON の場合にこの相 互作用が強くなり、配列構造が電場方向にそろい合うことに対応している。

電場印加による配列構造の変化を検討する新たな手法として、偏光異方性測定を行った。偏光 角が 0°および 90°の場合の吸光度を Av および AH とすると、吸光異方性 rA は、 ra=[Av-AH]/[Av+2AH]として定義される。電場 OFF または ON の場合の吸光異方性 rA を測定す ると、液晶結合金ナノロッドの DMF 溶液では、電場 ON の場合の rA 値が電場 OFF の場合に比 べて増加していた。一方、界面活性剤保護金ナノロッドの水溶液では電場印加による rA 値の変化 はほとんど見られなかった。この違いは、電場印加によって液晶結合金ナノロッドの集合構造が より異方的に変化することを示している。